

<オンラインセミナー>

「AI・デジタル産業時代の半導体熱設計」

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業に対しまして格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）では、半導体の熱設計手法として、半導体パッケージの熱モデルの標準化および熱モデルに使用する熱伝導率測定に関する活動を進めております。

今般、「AI・デジタル産業時代の半導体熱設計」と題するセミナーを企画し、メーカーにおける熱設計の取り組み、ROMによる集積回路の熱モデル化事例について、特別講演としてお話しいただくとともに、半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG における取り組みなどを紹介させていただきますことと致しました。

つきましては、この機会にぜひご参加いただき、各社の事業戦略・標準化戦略の立案に役立てていただくとともに、ご興味ございましたら同 SC への参画もご検討いただけますと幸いに存じます。

敬具

【開催概要】

日 時 : 2025 年 3 月 6 日 (木) 13:00~17:00

開催方法 : Webex によるリモート開催

主 催 : 一般社団法人電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会／半導体システムソリューション技術委員会
半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）／熱設計技術 WG

参加費 : 無料

申込方法 : 下記サイトよりお申し込みください。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/408/form>

お申し込みの際にご登録いただいたメールアドレス宛に、Webex への参加用のミーティングリンクをご案内させていただきます。(3 月 3 日に配信予定)

申込期限 : 2025 年 2 月 28 日 (金) までにお申し込みください。

プログラム：

時間	内容
13:00 - 13:20	開会挨拶・趣旨説明
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 主査
13:20 - 13:40	経済産業省様ご講演
	松岡 徹 氏 経済産業省 イノベーション・環境局 国際電気標準課
13:40 - 14:00	半導体構造設計技術 SC の活動紹介
	吉田 浩芳 半導体構造設計技術 SC 主査
14:00 - 14:50	<特別講演 1> 熱 CAE の社内推進とデータ駆動型設計の取り組み紹介
	下里 和史 氏、佐藤 一樹 氏 オムロン株式会社 技術・知財本部 デジタルデザインセンタ デジタルデザイン部 CAE・最適化グループ
14:50 - 15:20	熱設計技術 WG 活動紹介
	熊野 豊、武井 春樹 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 委員
15:20 - 15:40	休憩
15:40 - 16:30	<特別講演 2> BGA パッケージに対する EROM の適用
	浦郷 和幸 氏 株式会社ソシオネクスト グローバル開発本部 基盤開発部
16:30 - 16:50	熱設計技術 WG ・国プロ活動紹介 2
	羽鳥 仁人 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 委員
16:50 - 17:00	閉会挨拶
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 主査

※プログラムは、都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

■運営事務局・各種お問い合わせ先

一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部 事業推進部 担当：岩淵・遠山
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 E-mail：device3@jeita.or.jp

■個人情報保護について

お申込みいただいた皆様の個人情報は、本セミナーの受付をはじめ、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用致します。これらの目的以外で使用することはございません。JEITA の個人情報保護方針につきましては下記 URL をご参照ください。

[http://www.jeita.or.jp/japanese/](http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/)

以 上